

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-004

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称“芯联先锋”)拟向银行申请不超过人民币70亿元的项目贷款。
- 该事项无需提交公司股东大会审议
- 一、公司控股子公司申请项目贷款情况概述

根据芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容,计划三期12英寸中试项目的启动,预计在三年内合计形成投资222亿元人民币,人民币,10万片/月产能规模的三期芯联三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴芯联集成电路制造股份有限公司关于控股子公司与绍兴滨海新区管委会签订〈落户协议〉的公告》(公告编号:2023-005)。

公司于2023年5月31日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,同意公司新增募投项目“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”,具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2023-007)。

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,拟实施“二期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目”(以下简称“本项目”)。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。

为保证本项目的顺利实施,根据目前项目的建设计划,芯联先锋拟以本项目不超过价值人民币70亿元的设备作为抵押物向银行申请总额不超过人民币70亿元的项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等将以最终与银行签订的协议为准。芯联先锋将授权其总经理签署借款合同及其他相关文件。

二、审议程序

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的议案》,同意公司控股子公司向银行申请不超过价值人民币70亿元的设备作为抵押物向银行申请不超过人民币70亿元的项目贷款事项。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司

2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-006

芯联集成电路制造股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年1月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)2024年第一次临时股东大会
- (三)会议召开地点、董事会
- (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年1月26日14:00-16:00

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月26日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案

1 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2024年1月9日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、应回避表决的关联股东名称:不适用

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式行使表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2024年1月24日)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东(包括出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东)。

(二)2024年1月24日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

(二)登记手续:拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照(注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,除代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、加盖公章)、企业营业执照(注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项

股东或代理人参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

6. 其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理;

2. 联系人:张煜 赵超超

联系电话:0576-89421800 传真:0576-89420899

邮政编码:312100 邮箱:IR@nt-c.com

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司

2024年1月10日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

芯联集成电路制造股份有限公司:

兹委托女士(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号 事项授权议案名称 同意 反对 弃权

1 关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

受托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-005

芯联集成电路制造股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2024年1月9日(即现场结合通讯的方式)召开,会议通知于2024年1月2日向全体监事发出,会议应出席监事人数,实际出席监事人数,会议由监事会主席王永生先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》的议案

监事会认为:公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资,结合公司的实际经营情况未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,可以有效整合公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途、损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。

三、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》的议案

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是基于募投项目实施的实际情况,符合公司发展规划,能够充分发挥募集资金的使用效率,不存在变相

变更募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。

综上,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-003)。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-003

芯联集成电路制造股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2023年12月31日,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”已完成建设并达到预定可使用状态。目前,公司8英寸硅基晶圆生产线产能已达到17万片,同时已建成一条集研发和1.5万片12英寸数模混合集成电路特色工艺晶圆工程化、国产验证及生产验证的中试线项目。

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》,同意公司首次公开发行股票募投项目“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”结项,节余募集资金用于永久补充公司流动资金,独立董事对本次事项发表了明确的独立意见,保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1548号),并经上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)首次公开发行股票注册169,200.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币6.9元,募集资金总额为人民币962,748.00万元(行使超额配售选择权之前),扣除不含发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月6日出具了《验资报告》(天职业字[2023]33264号),验证募集资金已全部到位。

2023年6月8日,保荐人海通证券股份有限公司(主承销商)全权行使超额配售选择权,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,由此增加的募集资金总额为141,412.20万元,扣除发行费用(不含增值税)3,347.05万元,超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构(主承销商)已于2023年6月9日将全权行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2023年6月9日出具了《验资报告》(天职业字[2023]33539号)。

全权行使超额配售选择权后,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元,募集资金净额为1,078,341.70万元。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票注册三方/四方监管协议的公告》(公告编号:2023-019)。

二、募投项目实施情况

根据《绍兴芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目实施使用募集资金金额进行的调整(以下称“调整”)符合第十四次会议、第一届监事会第十次会议、第一届监事会第七次会议、第一届监事会第十一次会议关于新增募投项目对公司募投项目实施使用募集资金金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	截至2023年12月31日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项	65.64	-	-	-
2	二期晶圆制造项目	110.00	16.60	-	-
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆工程化、国产验证及生产验证中试线项目	42.00	22.10	-	-
4	三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目	180.00	27.90	-	-
5	补充流动资金	43.40	41.23	-	-
	合计	441.04	107.83	-	-

三、本次投资的募投项目募集资金使用及节余情况

(一)募投项目结项及节余募集资金情况

公司本次结项的募投项目为“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”,截至2023年12月31日,“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”已完成建设并达到预定可使用状态。目前,公司8英寸硅基晶圆生产线产能已达到17万片,同时已建成一条集研发和1.5万片12英寸集成电路特色工艺晶圆工程化、国产验证及生产验证的中试线项目。本次结项募投项目募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入总额	截至2023年12月31日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项	65.64	-	-	-
2	二期晶圆制造项目	110,000.00	16,600.00	4,967.12	4,967.12
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆工程化、国产验证及生产验证中试线项目	221,000.00	22,100.00	1,216.02	1,216.02
4	三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目	387,000.00	387,000.00	6,183.14	6,183.14
5	补充流动资金	43,400.00	41,230.00	-	-
	合计	927,000.00	818,930.00	12,357.28	12,357.28

注:截至2023年12月31日的募集资金银行存款利息及理财收益净额,实际金额以资金转出专户余额为准。

2、二期晶圆制造项目原拟投入募集资金66,600万元,其中自有资金预先投入募投项目

进行投资的金额为16,600万元,调整募集资金至中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目的金额为22,100万元,调整募集资金至三期12英寸数模混合集成电路制造项目的金额为27,900万元。

除募投项目结项产生的节余资金外,募集资金账户尚存有270.85万元拟用于支付发行费用的募集资金,其中120万元拟用于支付上市手续费用及其他费用,必须通过公司自有资金支付,另外269.65万元用于支付印花税,因印花税为一年一结,且必须使用公司账户支付上述款项,无使用募集资金账户结算,公司将以自有资金支付此笔费用。因此公司将上述270.85万元永久补充流动资金。

综上,公司本次将节余募集资金合计人民币6,453.99万元永久补充流动资金。

(二)注销募集资金专户情况

因募投项目“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”项目,公司将节余募集资金合计人民币6,453.99万元永久补充流动资金,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。同时公司将原用于“二期晶圆制造项目”的募集资金27,900万元调整至“三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目”,经公司股东大会审议通过,后将与芯联先锋及其开户银行和本次发行的主承销商签订相应的四方募集资金监管协议,并将募集资金27,900万元划转至相应募集资金专户。

为方便银行账户,上述资金划转完成后,公司拟对相应的募集资金专户进行注销,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。

截至2023年12月31日,公司拟注销募集资金专户的具体情况如下:

单位:元

序号	开户人	开户银行	账号	金额
1	芯联集成	招商银行股份有限公司绍兴分行	57590309610066	1,140,319,173.98
2	芯联集成	交通银行股份有限公司绍兴分行	3300011000130000403	1,560,001,892.24
3	芯联集成	浙江绍兴集成电路产业有限公司	337102011012010516340	4,734,676.67
4	芯联集成	兴业银行股份有限公司绍兴分行	390000110010016889	206,265,460.00
5	芯联先锋	浙江绍兴集成电路产业有限公司	3371020110120105109778	12,350,184.94
	合计			2,983,941,387.23

注:截至2023年12月31日,募集资金专户总余额与本次节余募集资金的账面余额合计划转至募投项目“二期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”27,900万元以及拟补充流动资金尚未使用的15,157万元。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中,公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成了上述募集资金节余。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次结项募投项目已实施完毕且已达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金6,453.99万元(为募集资金理财收益、银行存款利息的净额等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。公司将使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理专户手续。有关注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

六、专项意见

(一)独立意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,投入公司日常生产经营,履行了相应的审批程序,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定,是公司根据相关募投项目实施实际情况和使用情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是基于募投项目实施的实际情况,符合公司发展规划,能够充分发挥募集资金的使用效率,不存在变相

变更募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。

综上,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及监管制度的要求。公司将使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

2、《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-002

芯联集成电路制造股份有限公司

关于对外投资暨向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2023年12月31日,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目“MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项”、“二期晶圆制造项目”以及“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”已完成建设并达到预定可使用状态。目前,公司8英寸硅基晶圆生产线产能已达到17万片,同时已建成一条集研发和1.5万片12英寸数模混合集成电路特色工艺晶圆工程化、国产验证及生产验证的中试线项目。

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,同意公司新增募投项目“中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目”,具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2023-007)。

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,拟实施“二期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目”(以下简称“本项目”)。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。

为保障“二期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施,公司与绍兴富浙芯联集成电路产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“富浙芯联”)拟对芯联先锋进行第一期增资38.95亿元,其中公司增资28.875亿元,占本次增资总额的75%。公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金,0.975亿元为公司自有资金。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨向控股子公司增资的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

本次公司增资中来源于募集资金27.90亿元已经第一届董事会第十九次会议审议通过,尚须经股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。

(三)不属于关联交易暨重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创版)上市公司重大资产重组特别规定)规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

(一)绍兴富浙芯联集成电路产业股权投资合伙企业(有限合伙)

1.企业性质:有限合伙企业

2.注册地和主要办公地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路328号1幢4楼438室

3.执行事务合伙人:浙江富浙股权投资管理有限公司

<